

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# TRULY®

## 信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

主要交易  
財務資助  
建議擔保

### 建議擔保

茲提述本公司日期為二零一三年十二月十七日及二零一四年十一月十一日有關成立合資公司之公告，以及本公司日期為二零一五年八月十九日有關貸款協議之公告。

合資公司(作為借方)擬就一筆金額最高相等於人民幣3,100,000,000元之貸款(須待訂約各方磋商後方可作實)與聯合牽頭行及銀團銀行訂立銀團貸款協議，以撥資建造AMOLED產品生產線。合資公司全體合資公司股東，即信利半導體、惠州仲愷及惠州投資建議按彼等各自於合資公司之股權比例與聯合牽頭行及銀團銀行訂立擔保，以聯合牽頭行及銀團銀行利益就建議銀團貸款協議項下合資公司之責任為合資公司提供連帶責任擔保。各訂約方擬於建議擔保獲股東批准時簽訂銀團貸款協議及擔保。

### 上市規則之涵義

由於(1)預期建議擔保乃於簽訂增資協議及貸款協議後十二個月內訂立；及(2)建議擔保、貸款協議及增資協議共同使本公司高度參與AMOLED相關業務，而此業務過往並不屬於本公司主要業務活動之一部分，建議擔保、貸款協議及增資協議項下交易已合併處理。

由於合資公司並非本公司之附屬公司，故一經簽訂，擔保項下之交易即構成上市規則第14章項下之財務資助。由於有關信利半導體根據擔保建議提供擔保以及貸款協議及增資協議項下交易之若干適用百分比率合共超過25%，故一經簽訂，擔保項下之交易即構成上市規則第14章項下本公司之主要交易，須根據上市規則第14.40條獲股東於股東大會批准後方可作實。

## 股東特別大會

本公司將舉行股東特別大會以批准建議擔保及據此擬進行交易。載有(其中包括)建議擔保之進一步詳情及召開股東特別大會之通告之通函預期將於二零一五年九月七日或之前寄交股東。

本公司股東及潛在投資者務請注意，建議擔保受限於若干條件，包括但不限於股東批准，故可能或可能不會落實。因此，建議擔保可能或可能不會進行。故此，本公司股東及／或投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

茲提述本公司日期為二零一三年十二月十七日及二零一四年十一月十一日有關成立合資公司之公告，以及日期為二零一五年八月十九日有關貸款協議之公告。

合資公司(作為借方)擬就一筆金額最多相等於人民幣3,100,000,000元之貸款(須待訂約各方磋商後方可作實)與聯合牽頭行及銀團銀行訂立建議銀團貸款協議，以撥資建造AMOLED產品生產線。合資公司全體合資公司股東，即信利半導體、惠州仲愷及惠州投資建議與聯合牽頭行及銀團銀行訂立擔保，以聯合牽頭行及銀團銀行利益就建議銀團貸款協議項下合資公司之責任按彼等各自於合資公司所佔之股權比例為合資公司提供連帶責任擔保。各訂約方擬於建議擔保獲股東批准時簽訂銀團貸款協議及擔保。

建議銀團貸款協議之概要載列如下。

### 貸款、利息及安排費用

最高金額相等於人民幣3,100,000,000元(包括人民幣貸款及美元貸款)之八年期貸款，須待訂約各方磋商後方可作實。

首次提款日應於銀團貸款協議簽訂日期後兩個月內，而提款期將於首次提款日第二週年當日屆滿。

**人民幣貸款：**利率應指中國人民銀行就五年以上的貸款於各提款日頒佈之基準利率(最高為基準利率上浮百份之十，須待訂約各方磋商後方可作實，於本公告日期，現行中國人民銀行就五年以上的貸款年利率為5.4厘，上浮百份之十後即年利率5.94厘，僅供說明用途)，而應計利息應按以下方式計算：

未償還貸款金額 x 利率 x 天數/360

**美元貸款：**利率應指6個月倫敦銀行同業拆息加最多5厘(須待訂約各方磋商後方可作實)，而應計利息應按以下方式計算：

未償還貸款金額 x 利率 x 天數/365

**安排費用：**合資公司應付聯合牽頭行之建議銀團貸款協議項下貸款金額最多0.5%，須待訂約各方進一步磋商後方可作實

#### 貸款之抵押

除建議擔保外，AMOLED產品生產線所屬資產將抵押予聯合牽頭行及銀團銀行。

#### 貸款之目的

建議貸款將用作建設AMOLED產品生產線。

為確保AMOLED產品生產線之建設可及時獲得資金，信利半導體(作為貸方)及合資公司(作為借方)已於二零一五年八月十九日就人民幣500,000,000元之貸款訂立貸款協議。銀團貸款協議一經簽訂，部分貸款將用作償還貸款協議項下貸款。

建議擔保之進一步詳情載列如下。

## 擔保

### 訂約方

- (1) 信利半導體；
  - (2) 惠州仲愷；
  - (3) 惠州投資；及
- (上述各方，作為「擔保人」)
- (4) 聯合牽頭行及銀團銀行

### 主要事項

擔保人將以聯合牽頭行及銀團銀行利益就建議銀團貸款協議項下合資公司之責任，按彼等各自於合資公司所佔之股權比例為合資公司提供連帶責任擔保，包括償還建議銀團貸款協議項下之本金、利息及開支。

### 擔保之年期

建議擔保將在獲股東於股東特別大會批准後簽訂及生效，直至建造期屆滿，即二零一六年六月三十日或 AMOLED 產品生產線（其抵押可涵蓋建議銀團貸款協議項下之未償還貸款）完成並投入營運及獲聯合牽頭行及銀團銀行許可之日（以較後發生者為準）。為符合聯合牽頭行及銀團銀行之規定，所產生收益及除稅後溢利均須達到可行性報告所訂明者之 90%。

### 擔保人之其他承諾

根據建議擔保，各擔保人向聯合牽頭行及銀團銀行承諾，於建議擔保期內，擔保人須（其中包括）

- (a) 就擔保提供聯合牽頭行及銀團銀行所要求之資料，包括六月三十日前提提供過往財政年度之經審核財務報表；
- (b) 通知聯合牽頭行及銀團銀行任何可能對擔保構成不利影響之事件；

- (c) 倘擔保人轉讓其總資產20%以上且可能對擔保構成重大不利影響，須向聯合牽頭行及銀團銀行取得書面同意；及
- (d) 倘擔保人進行任何重大重組、大幅減少註冊資本或對組織章程細則作出重大修訂，必須通知聯合牽頭行及銀團銀行。

擔保人不得(其中包括)

- (a) 簽署任何對聯合牽頭行及銀團銀行利益構成不利影響之文件；
- (b) 採取任何對聯合牽頭行及銀團銀行利益構成不利影響之行為；及
- (c) 無正當理由而放棄經濟利益。

### 建議進一步就項目融資

就超出總建設預算之實際投資金額而言，包括信利半導體在內之各合資公司股東可能按彼等各自於合資公司所佔之股權比例向合資公司提供進一步財務資助。本公司將遵守上市規則，並於適當時候或倘上市規則規定，就向合資公司提供之任何額外財務資助另行作出公佈。

### 訂立建議擔保之理由及裨益

本公司認為AMOLED極可能成為新世代顯示器的主流技術。提供擔保可讓合資公司增加其營運資金以應付其持續拓展AMOLED相關建設及業務的需要，並促使本公司達致有關新世代顯示技術之策略性目標。

因此，董事會認為，訂立擔保符合本集團之利益。董事(包括獨立非執行董事)認為，擔保乃按一般商業條款訂立，而建議擔保之條款屬公平合理，且符合股東整體利益。

由於概無董事於建議擔保中擁有重大權益，因此，概無董事須就批准建議擔保之相關董事會決議案放棄投票。

## 有關本集團之資料

本集團之主要業務為製造及銷售液晶顯示器產品(包括觸控屏產品)及電子消費產品，包括微型攝像模組、個人保健護理產品及電子設備。

## 有關惠州仲愷及惠州投資之資料

惠州仲愷乃由惠州管理委員會全資擁有之國有企業，主要從事投資業務。

惠州投資乃由惠州市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有之國有企業，主要從事投資業務。

除上文披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知及全悉，惠州仲愷及惠州投資以及其各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

## 有關聯合牽頭行之資料

中國建設銀行股份有限公司惠州市分行(同時作為貸款代理)為金融機構。

中國進出口銀行為金融機構。

就董事經作出一切合理查詢後所深知及全悉，中國建設銀行股份有限公司惠州市分行、中國進出口銀行、銀團銀行以及彼等各自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

## 上市規則之涵義

由於(1)預期建議擔保乃於簽訂增資協議及貸款協議後十二個月內訂立；及(2)建議擔保、貸款協議及增資協議共同使本公司高度參與AMOLED相關業務，而此業務過往並不屬於本公司主要業務活動之一部分，建議擔保、貸款協議及增資協議項下交易已合併處理。

由於合資公司並非本公司之附屬公司，故一經簽訂，擔保項下之交易即構成上市規則第14章項下之財務資助。由於有關信利半導體根據擔保建議提供擔保以及貸款協議及增資協議項下交易之若干適用百分比率合共超過25%，故一經簽訂，擔

保項下之交易將構成上市規則第14章項下本公司之主要交易，須根據上市規則第14.40條獲股東於股東大會批准後方可作實。

## 股東特別大會

本公司將舉行股東特別大會以批准建議擔保及據此擬進行交易。載有(其中包括)建議擔保之進一步詳情及召開股東特別大會之通告之通函預期將於二零一五年九月七日或之前寄交股東。

本公司股東及潛在投資者務請注意，建議擔保受限於若干條件，包括但不限於股東批准，故可能或可能不會落實。因此，建議擔保可能或可能不會進行。故此，本公司股東及／或投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「AMOLED」	指	有源矩陣有機發光二極管，一種半導體產品
「董事會」	指	董事會
「增資協議」	指	由信利半導體、惠州仲愷及惠州投資就進一步投資於合資公司所訂立日期為二零一四年十一月十一日之增資協議，詳情於本公司日期為二零一四年十一月十一日之公告披露
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	信利國際有限公司，於開曼群島註冊成立之公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將予召開以考慮及酌情批准建議擔保之股東特別大會
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「擔保」	指	合資公司股東與聯合牽頭行及銀團銀行就提供貸款之連帶責任擔保而將訂立之擔保
「惠州投資」	指	惠州市投資控股有限公司，於中國註冊成立之公司，由惠州市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有
「惠州管理委員會」	指	惠州仲愷高新技術產業開發區管理委員會，惠州仲愷之唯一股東
「惠州仲愷」	指	惠州仲愷高新區投資開發有限責任公司，於中國註冊成立之公司，由惠州管理委員會全資擁有
「合資公司」	指	一間根據日期為二零一三年十二月十七日之股東協議由訂約方於中國共同成立之有限責任公司
「合資公司股東」	指	合資公司不時之股東
「聯合牽頭行」	指	中國建設銀行股份有限公司惠州市分行(同時作為貸款代理)及中國進出口銀行
「倫敦銀行同業拆息」	指	倫敦銀行同業拆息
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「貸款」	指	根據銀團貸款協議將授予合資公司之最高金額相等於人民幣3,100,000,000元之貸款，須待訂約各方磋商後方可作實
「貸款協議」	指	信利半導體(作為貸方)與合資公司(作為借方)就一筆人民幣500,000,000元之款項所訂立日期為二零一五年八月十九日之貸款協議
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「股東」	指	本公司不時之股份持有人
「附屬公司」	指	具公司條例第15條所賦予涵義
「銀團貸款協議」	指	合資公司與聯合牽頭行及銀團銀行就貸款將予訂立之銀團貸款協議
「信利半導體」	指	信利半導體有限公司，於中國註冊成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司
「美元」	指	美元，美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命  
信利國際有限公司  
主席  
林偉華

香港，二零一五年八月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生及張達生先生；非執行董事李建華先生以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啟誠先生。